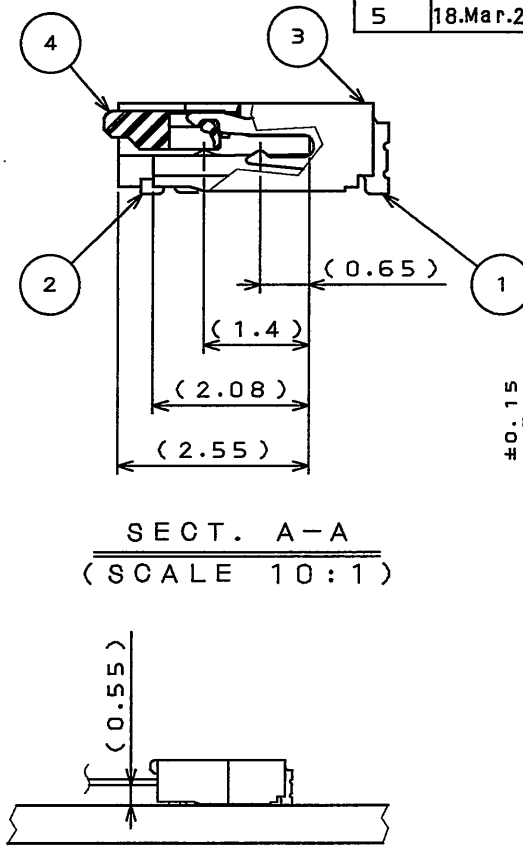
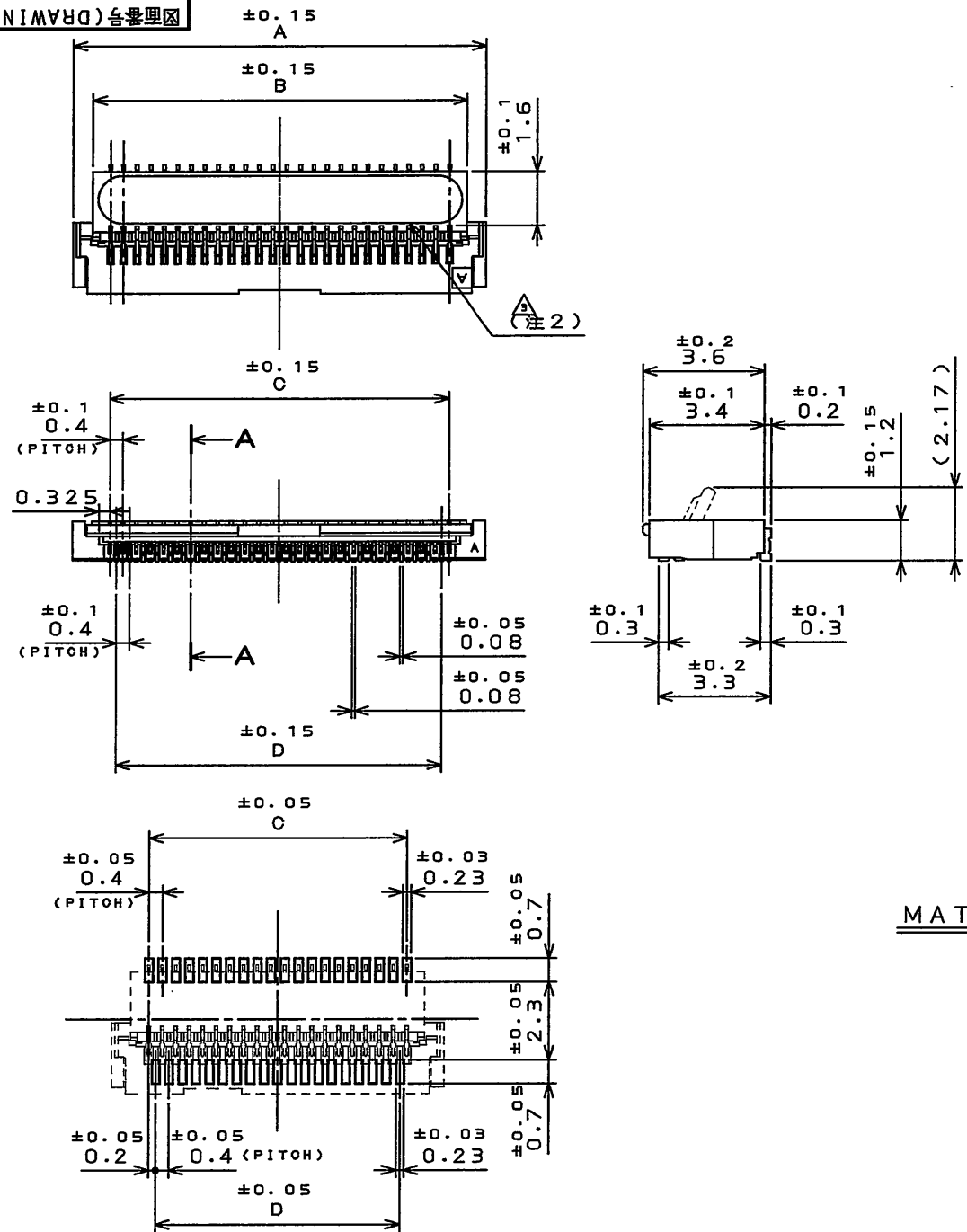
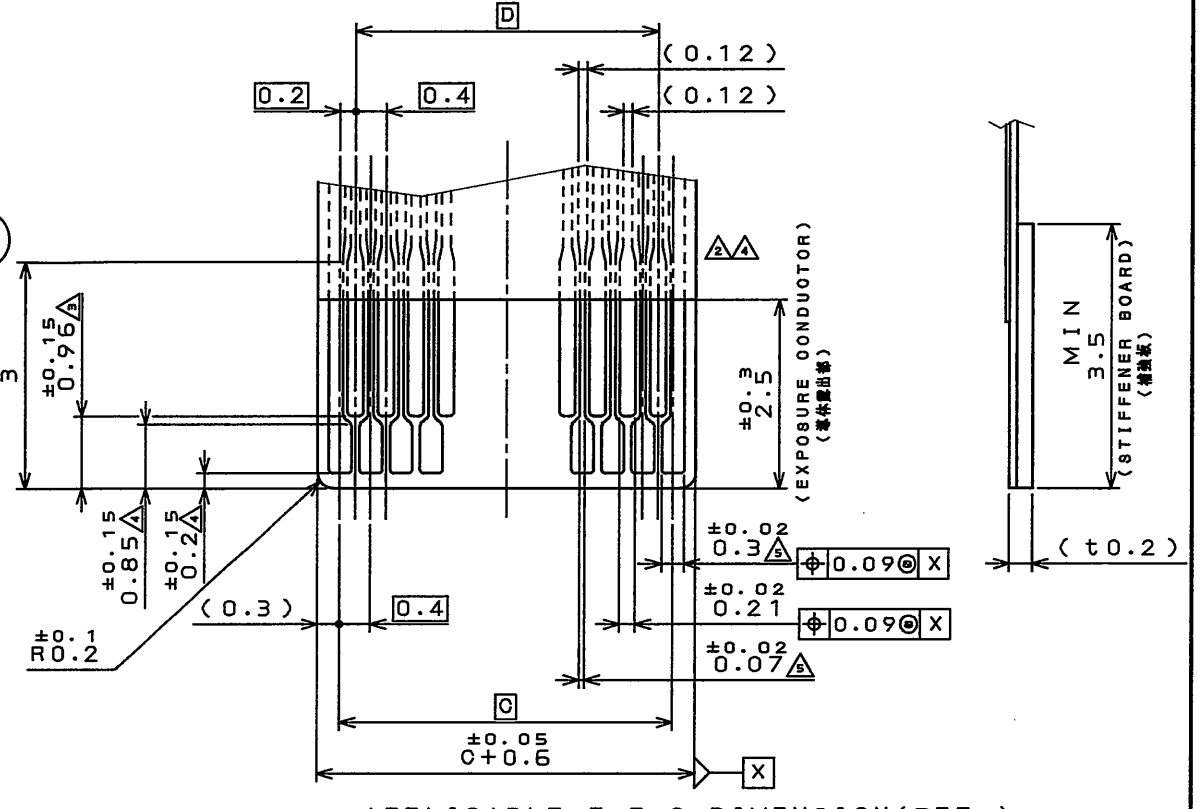


9ZEZ01RS  
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13.Sep.2007	063928	ADDED DIMENSION etc.	K.SHIMOJI	T.NAITOU	T.KUDOU	K.IBARAKI
3	29.Aug.2008	066479	ADDED LOT No.		T.NAITOU	T.KUDOU	K.IBARAKI
4	29.Jul.2009	068348	ADDED DIMENSION etc.		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
5	18.Mar.2010	068632	CHANGED APPLICABLE F.P.C DIMENSION		K.ASHIBU	T.Nemoto	A.Natori



SECT. A-A  
(SCALE 10:1)  
MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図 (参考)



APPLICABLE F.P.C DIMENSION (REF.)  
適合 F.P.C 寸法 (参考)  
(THICKNESS: 0.2 ± 0.03)

NOTE1. POLYIMIDE SHOULD BE USED AS A STIFFENER BOARD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHOULD BE USED. BARE TRACES SHOULD BE GIVEN GOLD PLATING.  
NOTE2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP OF THE CONNECTOR.  
NOTE3. ASSUME EXTERNALS CORNER OF THE CONDUCTOR TO BE R0.05 OR LESS.  
注1. 適合FPCの補強板はホリイミドを使用し、接着剤は熱硬化性を使用すること。又、仕上げは金メッキのこと。  
注2. ロット番号がコネクタ上面部に表記されます。  
注3. 導体の外形コーナーはR0.05以下とすること。

TABLE 1

NO. OF CONTACT	A	B	C	D
33	8.6	7.45	6.4	6.0
39	9.8	8.65	7.6	7.2
45	11.0	9.85	8.8	8.4
51	12.2	11.05	10.0	9.6
57	13.4	12.25	11.2	10.8
63	14.6	13.45	12.4	12.0

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

TABLE 2. RECOMMENDED FPC COMPOSITION

COMPOSITION 層名	RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド

4	ACTUATOR	1	GLASS FILLED NY	COLOR: BLACK UL94V-0
3	BASE INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	COLOR: BEIGE UL94V-0
2	CONTACT 2	$\frac{n-1}{2}$	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING
1	CONTACT 1	$\frac{n+1}{2}$	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION) JAGS-10414 J AHL-10414		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Apr.2007		尺度 (SCALE) 5:1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		シリーズ (SERIES) FG2
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. T.NAITOU		名称 (TITLE) FG2S***JA1
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T.KUDOU		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD. K.IBARAKI		
		質量 (MASS)		備考 REMARKS
				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
				図面番号 (DRAWING NO.) SJ107376
				版数 (REV.) 5

DOF-0-212F(05.08)

